

Compression Molding System

Model LCM1010 / 1030



**Compression molding system
for LED packages with a unique molding method**



独自のモールド方式を採用した LED パッケージ専用 コンプレッションモールド装置

- コンプレッションモールド成形で材料の使用効率向上
- 蛍光体入り樹脂成形や8 inch wafer 成形が可能
- 均一で安定したレンズ形状、及び高精度な成形品を実現
- オペレータによる基板セット、シリコン樹脂を金型へ自動供給
- プレスモジュールの増減による生産数量の変化への対応



SPECIFICATION

Items		Unit	Description	
モデル		—	LCM1010	LCM1030
ワークタイプ		—	基板・リードフレーム	
ワークサイズ		mm	1 strip type: 6 inch wafer / 70—150(W)×70—150(L) 2 strip type: 45—70(W)×50—150(L)	1 strip type: 4—8 inch wafer / 50—200(W)×100—300(L) 2 strip type: 50—100(W)×100—300(L)
樹脂		—	液状	
外形寸法	プレス数	module	1—4	1—3
	幅	mm	1,500—3,420	1,520—2,880
	奥行き	mm	1,400	1,600
	高さ	mm	1,700	1,850
重量		ton	2.6—8.0	3.8—9.4
成形取り数		workpiece	Strip: 1 or 2 / press Wafer: 1 / press	Strip: 1 or 2 / press Wafer: 1 / press
クランプ出力		kN / (tf)	29.4—98.0 / 3.0—10.0	29.4—294.0 / 3.0—30.0
クランプ速度		mm / sec	52 (Max.)	
リリースフィルム幅		mm	1 strip: 210 (Max.) 2 strip: 110 (Max.)	1 strip: 250 (Max.) 2 strip: 140 (Max.)
ディスペンサタイプ	プリミックスタイプ	—	○	○
	2液タイプ	—	○	×

- ・上記数値は当社標準機の場合です。
- ・改良のため仕様を変更する事があります。
- ・特殊システム仕様についてはご相談ください。
- ・外形寸法はプリミックスタイプディスペンサを採用時のものを記載しています。



本社

〒601-8105

京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地

お問い合わせ先

TOWA (当社のハウスマーク)、 はTOWA株式会社の商標または登録商標です。

海外販売拠点

中国
TOWA (Shanghai) Co., Ltd.台湾
TOWA Taiwan Co., Ltd.韓国
TOWA Korea Co., Ltd.シンガポール
TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd.マレーシア
TOWA Malaysia Sales & Services Sdn. Bhd.タイ
TOWA THAI COMPANY LIMITEDフィリピン
TOWA Semiconductor Equipment
Philippines Corp.インド
TOWA SEMICONDUCTOR INDIA
PRIVATE LIMITEDドイツ
TOWA Europe GmbHオランダ
TOWA Europe B.V.アメリカ
TOWA USA Corporation